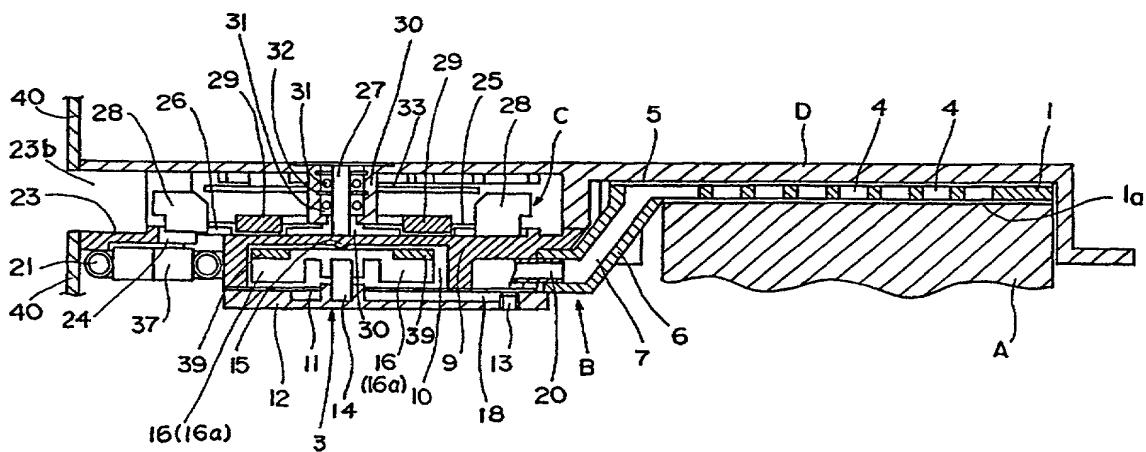




(51) 国際特許分類6 F25D 9/00, H05K 7/20		A1	(11) 国際公開番号 WO00/52401
			(43) 国際公開日 2000年9月8日(08.09.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/00940		(81) 指定国 AU, CA, CN, JP, KR, MX, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)	
(22) 国際出願日 1999年2月26日(26.02.99)		添付公開書類 国際調査報告書 補正書・説明書	
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本サーモスタット株式会社 (NIPPON THERMOSTAT CO., LTD.)[JP/JP] 〒204-0003 東京都清瀬市中里6丁目59番地2 Tokyo, (JP)		(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 魚森康治(UOMORI, Yasuharu)[JP/JP] 高橋正規(TAKAHASHI, Masanori)[JP/JP] 伊東聰(ITO, Satoshi)[JP/JP] 〒204-0003 東京都清瀬市中里6丁目59番地2 Tokyo, (JP)	
(74) 代理人 弁理士 木下 茂(KINOSHITA, Shigeru) 〒210-0912 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目42番地 金子ビル4階 Kanagawa, (JP)			

(54) Title: COOLING DEVICE OF ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称 電子機器の冷却装置



(57) Abstract

A cooling device of electronic device, comprising a liquid cooling mechanism (B) formed by providing liquid flow paths (4) in a heat absorber (1) in contact with an electronic device (A) and providing metal pipes (20 and 21) for connecting a pump (3) which feeds cooling liquid by the rotation of an impeller (16) to the liquid flow paths (4) and a forced-air cooling mechanism (C) formed by providing radiating fins (37) on the outer surfaces of the metal pipes (20 and 21), and providing a fan to exhaust air inside the metal pipes (20 and 21) with radiating fins (37) thereon and a cabinet to the outside thereof, the fan (25) and impeller (16) being provided with magnets (29 and 39), respectively, so as to simplify and downsize the structure of a drivingly rotating mechanism.